

ELMOS Semiconductor AG
Dortmund

Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2006

- Zur Einreichung zum Handelsregister -

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dortmund, 9. März 2007

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Muzzu
Wirtschaftsprüfer

Sultana
Wirtschaftsprüfer

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Gewinn- und Verlustrechnung für 2006

	EUR	EUR	2005 TEUR
1. Umsatzerlöse	143.136.051,06		124.911
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.626.415,52		2.518
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	385.951,75		429
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.721.888,08</u>		<u>2.953</u>
		148.870.306,41	<u>130.811</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-18.827.628,93		-16.405
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-39.821.002,28		-31.156
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-28.441.807,07		-25.543
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 154.781,12 (Vj. TEUR 70)	-5.197.534,57		-4.686
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.009.388,69		-9.335
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-43.245.344,37</u>		<u>-36.935</u>
		-146.542.705,91	<u>-124.060</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	2.696.569,83		2.417
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.696.569,83 (Vj. TEUR 2.417)			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		3.640
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	406.483,46		317
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 100.454,09 (Vj. TEUR 92)			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-176.492,57		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 782.883,68 (Vj. TEUR 136)	-1.992.757,69		-5.059
		<u>933.803,03</u>	<u>1.315</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.261.403,53	<u>8.066</u>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-446.185,92		-1.735
16. Sonstige Steuern	<u>-410.413,80</u>		<u>-207</u>
		<u>-856.599,72</u>	<u>-1.942</u>
17. Jahresüberschuss		2.404.803,81	6.124
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>42.532.947,25</u>	<u>36.409</u>
19. Bilanzgewinn		<u>44.937.751,06</u>	<u>42.533</u>

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund

Anhang für 2006

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Anders als im Vorjahr wird der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung aufgrund seines langfristigen Charakters im Finanzanlagevermögen und nicht mehr in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 - 8 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Ansprüche aus Rückdeckungsversicherung werden zum Aktivwert angesetzt.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Die **unfertigen und fertigen Erzeugnisse** sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen entsprechend dem steuerrechtlichen Mindestumfang berücksichtigt werden. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten vorgenommen.

Alle erkennbaren Risiken im **Vorratsvermögen**, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die **Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen** werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. Die Teilwerte gemäß § 6a EStG wurden unter Verwendung der „Heubeck-Richttafeln 2005 G“ aufgrund einer Änderung der biometrischen Grundlagen erstmalig in 2005 neu berechnet. Es liegt ein Rechnungszinsfuß von 6 % zugrunde.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zuschüsse auf Entwicklungsleistungen werden als Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Fremdwährungen wurden zu Umrechnungskursen am Tage ihrer Entstehung oder zu niedrigeren bzw. höheren Stichtagskursen bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt.

Entwicklung des Anlagevermögens 2006

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Kumulierte Abschreibungen		Buchwerte	
	1.1.2006 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	1.1.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Software und Lizenzen	24.039.615,62	661.649,21	347.491,67	87.258,08	24.961.498,42	13.013.910,14
2. Geleistete Anzahlungen	2.828.518,98	357.989,35	-347.190,18	1.842.001,59	997.316,56	0,00
	26.868.134,60	1.019.638,56	301,49	1.929.259,67	25.958.814,98	13.013.910,14
					87.251,96	12.944.904,84
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Bauten	12.362.231,97	1.477.068,91	162.143,81	612.300,00	13.389.144,69	3.561.667,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	93.041.202,98	2.524.737,22	7.957.018,08	876.778,81	102.646.179,47	71.281.357,75
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.136.846,08	1.182.764,55 ¹	267.776,68	244.333,91 ¹	9.343.053,40	6.193.261,64
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.114.293,41	8.007.357,96	-8.387.240,06	3.497.015,65	4.237.395,66	0,00
	121.654.574,44	13.191.928,64	-301,49	5.230.428,37	129.615.773,22	81.036.286,58
					73.929.561,60	48.579.486,64
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	63.300.420,79	49.000,00	0,00	0,00	63.349.420,79	63.300
2. Beteiligungen	567.751,77	0,00	0,00	0,00	567.751,77	81.259,20
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.602.930,49	764.900,16	0,00	766.937,84	1.600.892,81	0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.652.188,69	0,00	0,00	0,00	1.652.188,69	1.652
5. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen	0,00	1.419.646,00	0,00	0,00	1.419.646,00	0
	67.123.291,74	2.233.546,16	0,00	766.937,84	68.589.900,06	68.103.407,49
					310.000,00	176.492,57
	215.646.000,78	16.445.113,36	0,00	7.926.625,88	224.164.488,26	94.536.689,29
					84.543.435,21	129.627.798,97
					1.192.627,18	11.185.881,26

¹ Davon fiktiver Abgang geringwertiger Wirtschaftsgüter in Höhe von EUR 165.349,79.

Angaben zum Anteilsbesitz

	Währung	Beteiligungen %	Eigenkapital in TEUR/LW	Ergebnis in Tausend
Inland				
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt	EUR	33,33	191	148 ¹
attoSENSOR GmbH, Penzberg	EUR	45,00	54	4
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	173	510 ²
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	92	186 ²
ELMOS Semiconductor Süd GmbH, Unterschleißheim	EUR	100,00	174	8 ²
Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	100,00	29	-31
Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	94,00	2	18 ¹
GED Gärtner Electronic Design GmbH, Frankfurt/Oder	EUR	73,90	718	204
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund	EUR	100,00	113	4
IndustrieAlpine Bauträger GmbH, München	EUR	51,00	--	-- ³
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe	EUR	51,00	730	-136
ELMOS Industries GmbH, Hanau	EUR	49,00	-62	-162
Ausland				
Elmos Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	52.145	2.772
Elmos Advanced Packaging B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	958	72 ²
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	-1.691	-650 ²
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	11.980	-2.891 ²
European Semiconductor Assembly (Eurasem) B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	31.547	0 ²
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria (Südafrika)	ZAR	67,60	9	-89 ²
EL-MOS France S.A., Nanterre (F)	EUR	100,00	2.537	1.165
Elmos USA Inc., Michigan (USA)	USD	100,00	--	-- ³
ELMOS California Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	-272	-506 ²
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	-3.917	183 ²
Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	4.503	122 ²

¹ Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2006.

² Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

³ Es liegt bislang kein Jahresabschluss der Gesellschaft vor.

Forderungen und Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf einen Betrag von TEUR 103 (Vj. TEUR 1.438) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind aktivierte Forderungen auf Erstattung von verauslagten Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 418 (Vj. TEUR 1.055) enthalten. Der Aktivwert aus einer Rückdeckungsversicherung in Höhe von TEUR 1.420 (Vj. TEUR 1.358) wurde ins Anlagevermögen umgliedert.

Eigenkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2006 aus 19.413.805 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von EUR 19.413.805,00 ist voll eingezahlt.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 9.650.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um EUR 886.195,00, eingeteilt in 886.195 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).

Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Mitarbeiter haben im Jahr 2006 vom Optionsrecht zum Aktienerwerb Gebrauch gemacht, was erstmals zur Ausgabe von 1.381 nennwertlosen Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 EUR, die auf den Inhaber lauten, geführt hat und eine Kapitalerhöhung des Grundkapitals aus bedingtem Kapital zur Folge hatte. Die Kapitalrücklage erhöhte sich insgesamt um EUR 9.487,47 mit EUR 6,87 je Aktie.

Die verbleibenden Bezugsrechte haben sich zum 31. Dezember 2006 von 1.000.000 auf 886.195 verringert.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu EUR 5.000.000,00 eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus bis zum 25. April 2007 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100-prozentige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 26. April 2002 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100-prozentigen Beteiligungsgesellschaften bis zum 25. April 2007 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu nominal EUR 930.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durch Ausgabe von bis zu 930.000 neuen Stückaktien ohne Nennwert mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien und nur zur Einlösung von Bezugsrechten durchgeführt, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG in dem Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis zum 26. April 2009 gewährt werden. Der Vorstand – und soweit es die Mitglieder des Vorstands betrifft der Aufsichtsrat – wird angewiesen, im Rahmen dieses Aktienoptionsplans 2004 bis zu 930.000 Stück Bezugsrechte auf je eine Aktie der Gesellschaft an die unten bezeichneten Berechtigten unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in jährlichen Tranchen auszugeben. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG aus dem bedingten Kapital Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Bezugsrechte hiervon innerhalb der Ausübungsfrist Gebrauch machen. Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer Stückaktie ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00.

Es bestehen Bezugsrechte gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus einem Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter zum Erwerb von 715.201 Aktien.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 42.533 enthalten; im Übrigen verweisen wir auf den unten stehenden Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen wurden für Mitglieder des Vorstandes gebildet.

Die Steuerrückstellungen betreffen Ertragsteuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Tantiemen, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Garantieleistungen, Lizenzen, nachkommende Rechnungen, Aufsichtsratsvergütungen und Altersteilzeitansprüche gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegenüber Gesellschaftern.

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit				gesamt 31.12.2005
	gesamt 31.12.2006	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.603	31.603	0	0	24.671
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	69	69	0	0	350
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.632	7.632	0	0	7.875
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0	0	0	5.000
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23.343	23.342	0	0	8.017
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15	15	0	0	13
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1.331	1.185	146	0	(4.295)
- davon aus Steuern (Vorjahr)	377	377	0	0	(1.000)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	0	0	0	0	(697)

Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Die Darlehen sind durch eine Grundschuld am gewerblichen Objekt Emil-Figge-Straße 83/ Heinrich-Hertz-Str. 1 und Joseph-von-Fraunhofer-Str. 9, 44227 Dortmund (Eigentümer: Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz) gesichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, bis auf branchenüblich verlängerte Eigentumsvorbehalte von Lieferanten im Wesentlichen nicht besichert. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat eine Bürgschaft für eine Kreditlinie in Höhe von USD 2.500.000,00 übernommen, welche einem verbundenen Unternehmen gewährt wurde. Zum Abschlussstichtag hat das verbundene Unternehmen die Kreditlinie in Höhe von USD 1.931.904,00 in Anspruch genommen.

Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft hat einen Bonus Zinssatz-Swap für einen Nominalbetrag in Höhe von TEUR 20.000 und einer Laufzeit vom 14. April 2003 bis zum 14. April 2008 abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist der Tausch eines Festzinssatzes in Höhe von 5,250 % p. a. gegen einen variablen Zinssatz in Höhe der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR-Telerate) für 3-Monatsgelder.

Zum Stichtag wurde das Finanzderivat zum Marktwert von EUR 76,18 bewertet. Eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften war nicht zu bilden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Leasingverträge für das Betriebs- und Verwaltungsgebäude, das Mitarbeiterzentrum, das Parkhaus sowie für ein weiteres Bürogebäude abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2014, 2020, 2021, 2022 und 2030 erstrecken. Außerdem hat die Gesellschaft Leasingverträge für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2008 und vereinzelt bis 2011 erstrecken. Daneben bestehen Leasingverträge für den Fuhrpark, Büromaschinen und technische Anlagen und Maschinen in betriebsüblichem Umfang.

Die Gesellschaft hat einen Vertrag über gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie zur Nutzung einer Produktionslinie mit einer Laufzeit bis 2015 abgeschlossen.

Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden nichtkündbaren oben genannten Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

	<u>TEUR</u>
2007	21.825
2008	15.318
2009	12.109
2010	10.319
2011	12.578
Folgejahre	59.174

Aus erteilten Investitionsaufträgen besteht ein Bestellobligo von TEUR 4.644.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2006 <u>TEUR</u>	2005 <u>TEUR</u>
- nach Sparten		
Produktion	139.661	121.515
Entwicklung	3.190	2.929
Sonstiges	<u>285</u>	<u>467</u>
Nettoumsatzerlöse	<u><u>143.136</u></u>	<u><u>124.911</u></u>
- nach Regionen		
Inland	54.836	46.885
Übrige EU-Länder	57.051	54.681
USA	13.246	16.804
Übrige Länder	<u>18.003</u>	<u>6.541</u>
Nettoumsatzerlöse	<u><u>143.136</u></u>	<u><u>124.911</u></u>

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Währungsdifferenzen (TEUR 395), Erträge aus Anlagenabgängen (TEUR 4), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 333), Erträge aus Projektförderungen (TEUR 363) und Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 204). Darüber hinaus werden im Wesentlichen Erträge aus privater Pkw-Nutzung (TEUR 293), Erhöhung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung (TEUR 138), Erstattungen sonstiger Steuern (TEUR 376), Mieterträge (TEUR 167) und Weiterbelastungen an IMS (TEUR 1.100) ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen aus Garantieleistungen (TEUR 1.262).

Honorare für Abschlussprüfer

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar für Abschlussprüfer gliedert sich auf in die Bereiche Abschlussprüfung (TEUR 85), sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen (TEUR 32), Steuerberatungsleistungen (TEUR 178) sowie sonstige Leistungen (TEUR 1).

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer, Duisburg, pensionierter Institutsleiter (Vorsitzender)
Dr. Burkhard Dreher, Dortmund, Diplom-Volkswirt (stellvertretender Vorsitzender)
Herbert Sporea, Altwittenbek, Kaufmann (bis zum 31. Dezember 2006)
Jutta Weber, Tarrytown, New York, Diplom-Pädagogin
Jörns Haberstroh, Kerken, Diplom-Ökonom
Dr. Peter Thoma, Unterschleißheim, Diplom-Physiker

Herr Prof. Dr. Günter Zimmer übt drei weitere Aufsichtsratsmandate (Siltronic AG, active photonics AG, Dolphin Integration S.A.), Herr Dr. Burkhard Dreher weitere drei (GfV AG, EKO Stahl GmbH, Vattenfall Europe Mining AG), Herr Herbert Sporea übt zwei weitere Mandate aus (Beiratsmitglied der Mechaless Systems GmbH, Beiratsmitglied der 49-Systems GmbH), Herr Jörns Haberstroh weitere vier (Ehlebracht AG, 3M-Quante AG, QSC AG, Beiratsmitglied der Mechaless Systems GmbH), Herr Dr. Peter Thoma übt zwei weitere Mandate aus (Behr GmbH & Co. KG und Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG).

Vorstand

Dr. rer.-nat. Klaus Weyer, Schwerte (bis zum 31. Dezember 2006)
Diplom-Physiker Dr. rer. nat. Anton Mindl, Lüdenscheid (Vorsitzender)
Dr. rer.-nat. Frank Rottmann, Dortmund
Diplom-Ingenieur Reinhard Senf, Iserlohn
Diplom-Volkswirt Nicolaus Graf von Luckner, Oberursel (seit 1. Juli 2006)

Herr Dr. Weyer übt zwei Aufsichtsratsmandate aus (Aufsichtsrat der Paragon AG, Projektbeirat der MST Dortmund).

Gesamtbezüge des Vorstands

Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe Bezüge und variable, erfolgsorientierte Bezüge auf, die sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ableiten. Demnach betragen die Bezüge des Vorstands für 2006 insgesamt TEUR 2.087. Hiervon entfallen auf den fixen Bestandteil TEUR 1.522 und auf den variablen Teil TEUR 565.

In der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 wurde mit einer $\frac{3}{4}$ -Mehrheit beschlossen, die Angaben gemäß § 285 I Nr. 9a Satz 5 - 9 HGB für die folgenden fünf Jahre zu unterlassen.

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im Geschäftsjahr 2006 TEUR 132. Für sie wurde eine Pensionsrückstellung in Höhe von TEUR 1.035 gebildet.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Vorstand

Dr. Klaus Weyer	10.000 Stück	25.000 Optionen
Dr. Anton Mindl	7.250 Stück	0 Optionen
Dr. Frank Rottmann	0 Stück	9.200 Optionen
Reinhard Senf	1.948 Stück	40.000 Optionen
Nicolaus Graf von Luckner	1.000 Stück	0 Optionen

Der durchschnittliche beizulegende Wert der Aktienoptionen betrug EUR 14,23 für die erste und zweite Tranche, EUR 4,40 für die dritte Tranche, EUR 5,07 für die vierte Tranche und EUR 6,06 für die fünfte Tranche.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich für 2006 insgesamt auf TEUR 100. Hierbei handelt es sich nur um fixe Bestandteile (inkl. Spesen und Auslagen).

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2006 keine Aktienoptionen mehr ausgegeben.

Für sonstige Dienstleistungen – insbesondere Beratungen – vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2006 TEUR 276.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer	0 Stück	0 Optionen
Herbert Sporea	4.165 Stück	0 Optionen
Jörns Haberstroh	3.956 Stück	0 Optionen
Dr. Peter Thoma	9.200 Stück	40.000 Optionen
Dr. Burkhard Dreher	1.900 Stück	0 Optionen
Jutta Weber	200 Stück	0 Optionen

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte fanden in 2006 statt:

- Dr. Anton Mindl: Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 9,55 am 30. März 2006
Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 7,97 am 23. Mai 2006
Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 7,95 am 24. Mai 2006
- Felix Christian Mindl (minderjähriger Sohn von Dr. Anton Mindl):
Kauf von 100 Aktien zu EUR 7,84 am 6. Juni 2006

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Gewerbliche Arbeitnehmer	254	210
Angestellte (inkl. Teilzeitkräfte umgerechnet auf Vollzeit)	<u>395</u>	<u>383</u>
	<u><u>649</u></u>	<u><u>593</u></u>

Konzernverhältnisse

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, befindet sich im mittelbaren Mehrheitsbesitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, die nach § 290 Abs. 2 Nr. 2 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Die Aufstellung eines Konzernabschlusses durch die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, zum 31. Dezember 2006 erfolgte bislang nicht.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt (in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn von EUR 44.937.751,06 auf neue Rechnung vorzutragen.

Erklärung gemäß § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, haben die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären zugänglich gemacht.

Dortmund, im März 2007

Der Vorstand

Dr. Anton Mindl Nicolaus Graf von Luckner Dr. Frank Rottmann Reinhard Senf

LAGEBERICHT DER ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Geschäft und Rahmenbedingungen

Geschäftstätigkeit

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte, zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische Schaltkreise, vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2006 entfielen rund 90 Prozent vom Umsatz auf dieses Marktsegment. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat ELMOS sich eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet. Unverändert wird ELMOS, wie auch in den vergangenen Jahren, mit 12 Prozent Marktanteil von dem Marktforschungsinstitut Gartner Dataquest im März 2006 als die weltweite Nummer drei im Segment der ASICs (Application Specific Integrated Circuits) für den Automobilmarkt nach den Firmen STMicroelectronics und NEC aufgeführt. Die direkten Wettbewerber AMI Semiconductor und Melexis folgen auf den Plätzen vier und fünf.

ELMOS-Chips werden von nahezu allen europäischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs sowie an Sicherheit und Komfort führen zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Automobile Neuprojekte benötigen in der Regel drei bis vier Jahre Entwicklungszeit, bevor sie für etwa fünf Jahre in Serie produziert werden. Teilweise verlängert sich diese Produktionszeit erheblich, wenn Autohersteller eine ähnliche technische Plattform in einer Familie von neuen Modellen einsetzen. Zum Zeitpunkt des Gewinns eines Neuprojekts werden in der Regel die Preise in Abhängigkeit von geplanten Mengen für die gesamte Projektlaufzeit kalkuliert.

Seit mehr als 20 Jahren bedient ELMOS Nischenmärkte mit eigenem Know-how. Es ist die Strategie, zum einen durch eine konsequent an den Marktbedürfnissen ausgerichteten Fertigungstechnologie und zum anderen durch die kundenspezifische Produktentwicklung zu überzeugen. So entwickelt ELMOS in der Regel Produkte im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv für diesen Kunden. ELMOS ist bestrebt, als kompetenter Partner der Kunden mit maßgeschneiderten, integrierten Schaltungen ein profitables Geschäft zu betreiben und die eigenen Marktanteile zu erhöhen.

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die etwa 90 Prozent der Produkte umfassen, verfügt ELMOS zudem über ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von mikromechanischen Sensoren aus der Produktion der Tochtergesellschaft Silicon Microstructures Inc. (SMI) in Milpitas, Kalifornien, USA. SMI entwickelt, produziert und vertreibt mikromechanische Bauelemente (MEMS) und zählt zu den Technologieführern im Bereich der hochpräzisen Drucksensoren in Silizium. Neben Drucksensoren entwickelt SMI Sensoren für Beschleunigung und Drehbewegungen, die speziell für die Automobilindustrie geeignet sind. Mit einer eigenen Fertigung in Kalifornien verfügt SMI über stabile Serienfertigungseinrichtungen und -fähigkeiten. Darüber hinaus unterstützt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio. ELMOS AP entwickelt und fertigt Gehäuse für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Neben Standardgehäusen gemäß JEDEC-Normen gehören vor allem kunden- und applikationsspezifische Spezialgehäuse, die sich teilweise durch patentiertes Know-how vom Wettbewerb unterscheiden, zum Produktportfolio. Die Fabrik in Nijmegen entspricht dem modernsten Stand der Technik. ELMOS AP deckte in 2006 noch rund 40 Prozent des Assembly-Bedarfs für ELMOS ab. Neben der konzerninternen Assemblierung fertigt die Gesellschaft auch Sondergehäuse für Drittkunden. In Zukunft wird sich ELMOS AP komplett auf die Entwicklung und Herstellung von Spezialgehäusen fokussieren. Die Produktion von Standardgehäusen wird zu langjährigen Partnern nach Südostasien verlagert.

ELMOS produziert alle ASICs in einer eigenen Produktionsstätte für Halbleiterbauelemente (Wafer-Fab) in Dortmund sowie in der im Berichtsjahr in Betrieb genommenen Produktionslinie in Duisburg. Sowohl durch die automobilgerechte Hochvolt-CMOS Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip Treiberleistungen unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern.

Der in 2005 neu geschaffene Bereich ELMOS Microsystems ergänzt dieses Angebot durch die Entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-mechatronischen Modulen. Diese Module kombinieren die Fähigkeiten der drei entwickelnden und produzierenden Unternehmen der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren und funktionalem Gehäuse. Damit kann der Kunde kostengünstige Systemlösungen realisieren.

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS außerdem im Industrie- und Konsumbereich tätig und liefert kundenspezifische Schaltkreise z.B. für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Installations- und Gebäudetechnik und Maschinensteuerungen. Diese nicht automobilen Märkte werden in Zukunft von der im Berichtsjahr gegründeten ELMOS Industries intensiv betreut. Sie haben im vergangenen Jahr, wie in den Vorjahren, rund zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht.

Strategie

ELMOS ist mit einer klaren Strategie in das Berichtsjahr gestartet und hat dabei deutliche Fortschritte gemacht. Im Vordergrund stand die Fokussierung auf kundenspezifische, automobiler Applikationen, bei denen ELMOS jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der automobilen Halbleiter hat. Hier war die Inbetriebnahme der zweiten Produktionsstätte in Duisburg sowohl für die Versorgungssicherheit als auch für die Nutzung der Kostensenkungspotentiale aufgrund des größeren Waferdurchmessers ein wichtiger Schritt. Erste Kundenfreigaben wurden im dritten Quartal erteilt, weitere folgten zum Jahresende.

Daneben stand der Ausbau der Entwicklung und des Vertriebs von Applikations-Standards (ASSPs) im Fokus. Hierfür hat ELMOS den Bereich Applikationen & Systeme (AS) geschaffen, der gezielt Applikations-Standards produziert und vertreibt. Hierbei fließen insbesondere auch patentrechtlich geschützte Verfahren wie HALIOS® und VirtuHall® ein, die für ELMOS Wettbewerbsvorteile bringen. Eine derartige Familie von Applikations-Standards erlaubt dem Anwender die schnelle und einfache Realisierung von intelligenten Lösungen z.B. für Sensor- bzw. Antriebsanwendungen.

Mikrosysteme, bestehend aus ASICs und MEMS in einem kundenspezifischen Package, stoßen derzeit auf großes Interesse im Markt. Mit der Fähigkeit, solche Systeme im internen Firmenverbund zu entwickeln und zu produzieren, grenzt sich ELMOS klar von seinen Wettbewerbern ab und offeriert ihren Kunden einen einzigartigen Vorteil.

Fortschritte wurden auch bei der Integration von Fremdsilizium in eigene Systemlösungen erzielt. Erste Projekte, basierend auf nicht selbst produzierten Bauelementen, wurden bis zur Prototypenreife vorgebracht. Diese Zukaufelemente werden entweder bei strategischen Partnerfirmen oder bei großen Halbleiterfoundries in von ELMOS nicht angebotenen Technologien nach Konstruktionsplänen von ELMOS produziert. Dank der technischen Möglichkeiten von ELMOS AP werden eigene und fremdbezogene Bauelemente in funktionalen Gehäusen als Multi-Chip-Modul zusammengefasst.

Schließlich wurde die geplante Adressierung zusätzlicher Märkte neben dem Automobilmarkt durch die Gründung der ELMOS Industries umgesetzt. Diese Tochterfirma hat im vierten Quartal des Berichtsjahres ihre Arbeit aufgenommen. Für nicht-automobile Märkte, d.h. Industrie- und Konsummärkte, strebt ELMOS mittelfristig einen Umsatzanteil von 20 bis 30 Prozent des Gesamtumsatzes an.

Rahmenbedingungen

Automobiler Halbleitermarkt

Der für ELMOS relevante Markt ist der der Halbleiterchips für die Automobilindustrie. Dieser Markt stellt einen Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Er umfasst weltweit einen Anteil von rund sieben Prozent des gesamten Halbleitermarkts. Bedingt durch den Einfluss der relativ konstanten Automobilproduktion und des zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobiler Halbleitermarkt eine deutlich höhere Stabilität auf als der globale Halbleitermarkt, welcher hauptsächlich durch die Entwicklungen bei Speicher- und Kommunikationschips geprägt ist. Es wird erwartet, dass der Wertanteil der Elektroniksysteme bei höherwertigen Fahrzeugen von heute rund 25 Prozent bis 2010 auf rund 35 Prozent ansteigen wird. Elektronik und Mikroelektronik für den Automobilsatz wuchsen in der Vergangenheit und wachsen auch langfristig um ein Vielfaches schneller als die Zahl der neu produzierten Kraftfahrzeuge. Eine Fortsetzung dieses Trends ist mindestens für die nächsten zehn Jahre zu erwarten.

Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts sind die für die Halbleiterbranche untypisch lange Produktlebensdauer und die dadurch bedingten langen Lieferzeiträume von teilweise mehr als zehn Jahren. Zudem unterscheidet sich der Markt durch langfristige Kunden-Lieferanten Beziehungen und die sehr hohen Qualitätsanforderungen sowie besonders harte Umgebungsbedingungen, die robuste Halbleitertechnologien erfordern.

Der weltweite Markt der automobilen Halbleiter betrug im Jahr 2006 19,1 Milliarden US-Dollar. Für die kommenden Jahre sagen Experten ein Wachstum für den automobilen Halbleitermarkt von sieben bis acht Prozent pro Jahr voraus. So erwartet das Marktforschungsinstitut Semicast Estimates, dass der Markt bis 2015 auf 36,5 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.

Der von ELMOS maßgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, nämlich der der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter, der sogenannten ASICs.

Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstückzahlen stehen diese ASICs nicht im Fokus der großen Halbleiterhersteller, welche die Auslastung für ihre großen Produktionskapazitäten benötigen. Weitere Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschäftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden zu einem einzelnen ASIC-Hersteller, die unter anderem aus dem Wunsch des Kunden nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen. Wettbewerber der ELMOS sind bei typischen ASIC-Projekten mit mittleren Stückzahlen Firmen ähnlicher Größe wie AMI Semiconductor, Melexis, austria micro systems und Micronas. Bei sehr großen Stückzahlen steht ELMOS auch in Konkurrenz zu Großproduzenten wie Infineon, ST Microelectronics und Freescale.

Wirtschaftliches Umfeld

Im Jahr 2006 hat sich der Trend des Jahres 2005 fortgesetzt. Die Konsolidierung im Automobilmarkt hält unvermindert an, die Anzahl der Zulieferer sinkt. Die durchschnittlichen Volumina der Projekte steigen an und damit auch der Preisdruck. Dieser wird von den Automobilherstellern in Form von Kostensenkungsprogrammen an die sogenannten „Tier 1“ Hersteller, die Zulieferer der ersten Reihe, weitergegeben. Diese reichen den Preisdruck bei der Verhandlung von Neuprojekten an ihre Zulieferer weiter.

Da die Produktentwicklungszeiten in der Automobilindustrie immer kürzer werden, steigt auch der Termindruck an. Durch eine nach langfristigen Verhandlungen verspätete Auftragsvergabe wird die Situation häufig noch verschärft. Andererseits können selbst kleinste Überschreitungen des Projektendtermins dazu führen, dass ein Auftrag nicht in die Produktion überführt werden kann.

Auch bei der Übernahme der Entwicklungskosten gelten härtere Spielregeln. Früher hat der Kunde in der Regel rund die Hälfte der Entwicklungskosten übernommen. Heute ist die Bereitschaft zur Übernahme von Entwicklungskosten durch den Kunden stark rückläufig, was sich durch den härteren Wettbewerb erklären lässt. Damit wächst die Gefahr, dass der Kunde ein Projekt abbricht, z.B. weil er den Auftrag von seinem Endkunden verloren hat.

Besonders bei sehr großen Projekten verlangt der Kunde in der Regel die Umlage der Entwicklungskosten in die Serie. Zudem sind hier häufiger parallele Entwicklungen durch zwei Lieferanten – im Gegensatz zum früher üblichen Single-Sourcing – anzutreffen. Eine Folge davon und des starken Kostendrucks ist, dass heutzutage ein Wechsel des Zulieferers bei derartigen Projekten sogar während der Serienproduktion eines Fahrzeugs möglich ist.

Geschäftsverlauf im Jahr 2006

Das Jahr 2006 verlief für ELMOS insgesamt zufriedenstellend. Nach dem deutlichen Einbruch im dritten Quartal 2005 konnte seither Quartal für Quartal ein Umsatzwachstum sowie eine Verbesserung der wesentlichen Kennzahlen erzielt werden. Insgesamt wurde im Berichtsjahr ein Umsatz von 143,1 Millionen Euro erreicht, dies entspricht einem Wachstum von fast 15 Prozent ausgehend von 124,9 Millionen Euro Vorjahresumsatz. Dies ist umso bemerkenswerter, da der amerikanische Automobilmarkt eine ausgeprägte Schwäche zeigte und unsere Umsatzerwartungen dort um mehr als zehn Prozent verfehlt wurden.

Die negativen Einflussfaktoren des Vorjahres wie Preisdruck, veränderter Produktmix sowie Verschiebungen und Stornierungen von Projekten wirkten auch im Berichtsjahr fort. Daneben mussten die deutlich gestiegenen Rohstoffkosten – vor allem für Siliziumwafer, aber auch für Edelmetalle – und die höheren Energiekosten aufgefangen werden. Schließlich belasteten die Aufwendungen für den Anlauf der zweiten Fertigungslinie in Duisburg sowie Vorleistungen für Mikrosysteme und ASSPs die Bruttomarge, die bei einer Marke von 45% im Jahresverlauf verharrte.

Produktion

In 2006 wurden 15 Prozent mehr Chips produziert als im Jahr zuvor. Dabei sind die Anforderungen an die Produkte und damit deren Komplexität, gemessen an der Anzahl der zu strukturierenden Ebenen (Layer), erheblich gestiegen.

Die 2006 an Kunden ausgelieferten ASICs und ASSPs wurden überwiegend am Hauptstandort Dortmund auf der 150mm-Wafer-Linie (entspricht 6 Zoll) produziert. Die Produktion auf der 200 mm-Wafer-Linie (entspricht 8-Zoll) am Standort Duisburg wurde in der zweiten Jahreshälfte für ausgewählte automotiv ASICs lieferwirksam.

Die Linie in Dortmund wurde im Berichtsjahr weiter planmäßig ausgebaut, um für die nächsten Technologie-Generationen und den steigenden Kapazitätsbedarf der Produktion vorbereitet zu sein.

Zum Jahresende 2006 lag die Maschinenkapazität bei rund 480 Waferstarts pro Tag; die durchschnittliche Ausnutzung übertraf mit 430 Waferstarts pro Tag das Niveau des Vorjahres (rund 400 Waferstarts). Insgesamt wurden in 2006 über 177.000 Wafer (2005: ca. 131.000 Wafer) gefertigt.

Die Kapazität der bestehenden Produktionslinie in Dortmund kann nach wie vor durch Rekrutierung weiterer Mitarbeiter und durch weitere Investitionen in Maschinen und den Ausbau von Räumen erweitert werden. Im Jahr 2006 wurde der vierte Bauabschnitt fertiggestellt, der neue Reinraumflächen für die Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2006 verfügbar machte. Dieser Baukörper wird seit dem dritten Quartal 2006 für eine Erweiterung unseres Testbereiches genutzt und kann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auch Raum für die Erweiterung des Frontends schaffen.

Der zweite Baustein zur Kapazitätssicherung ist die Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg. ELMOS hat in 2006 den Transfer erster Prozesstechnologien und die Qualifikation der dort existierenden 200mm-Wafer-Linie abgeschlossen sowie die Freigabe erster Produkte erreicht. Wie geplant konnten ab Mitte 2006 die Produktionslose in Duisburg gestartet und geliefert werden.

Der behutsame Ausbau der Kapazitäten in Dortmund, die neue Produktionsstätte in Duisburg sowie der zukünftige Nutzung von Foundry-Kapazitäten stellen die erforderliche Fertigungskapazität für die mittelfristige Zukunft der ELMOS sicher.

Im Geschäftsbereich Assembly (ELMOS AP) wurde im Geschäftsjahr 2006 mit der Verlagerung von Standardprodukten zu Assemblypartnern im asiatischen Raum begonnen. Damit wurden interne Kapazitäten für höherwertige Spezialprodukte geschaffen und die Kostenvorteile aus dem Euro-Dollar-Wechselkurs erschlossen. Im Laufe des Jahres 2007 soll die Verlagerung der Standardgehäuse abgeschlossen werden.

Forschung und Entwicklung

Die hohen Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit führen zu verlangsamer Einführung neuer Technologiegenerationen bei Halbleitern in der Automobilelektronik. Allerdings nutzen Industrie- und Konsumgütermärkte neue Technologien als Innovationstreiber. ELMOS nutzt diesen Sachverhalt indem z.B. in Konsumgütermärkten gereifte Innovationen später im Automobil eingeführt werden. Dies führt zu besserer Qualität auch bei neuen Produkten für das Automobil.

Im Berichtsjahr war ein klarer Schwerpunkt der Aktivitäten in Forschung und Entwicklung der Abschluss des Transfers des 0,8µm-Prozesses zum Standort Duisburg. Die ersten Kundenfreigaben wurden planmäßig im Sommer erteilt. Im weiteren Verlauf des Jahres startete der Serienanlauf mit transferierten Produkten. Die Arbeiten zur Entwicklung neuer Prozesstechnologien mit kleineren Strukturgrößen (0,35µm-Technologie) und Flash-Option machten einen weiteren Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung aus. Diese Aktivitäten wurden parallel dazu in Duisburg direkt in der 200-mm-Linie durchgeführt, um mit den hochintegrierenden Technologien und den großen (200mm) Wafern den größten Kostenvorteil zu erreichen. Damit verfolgt ELMOS weiterhin die Strategie, durch eigene Prozesstechnologien innovative und wettbewerbsüberlegene Lösungen anbieten zu können.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfällt der mit Abstand größere Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Wie schon in der Vergangenheit, verstärkte sich im Jahr 2006 die Tendenz, dass der Kunde die Kosten für Forschung und Entwicklung eines ASICs nicht mehr übernimmt. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Produktentwicklungskosten vom ASIC-Lieferanten, das heißt ELMOS, vorfinanziert werden muss und sich erst über die Serienfertigung amortisieren kann. Dies trifft natürlich in besonderem Maße für die Entwicklung von ASSP-Familien zu.

Mitarbeiter

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. Am Standort Dortmund in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit diesen und genießt als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll und mittels einer Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung. In zahlreichen Ausschüssen werden die

Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zur Geschäftsleitung besprochen und geregelt. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

Mitarbeiterbeteiligung/Aktienoptionsprogramme

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit über Aktienoptionsprogramme am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Diese Programme sehen die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb des Vorstands und zu identischen Bedingungen an den Vorstand vor. Für Tranchen seit 2004 gilt für den Vorstand als zusätzliche Bedingung eine Begrenzung der Wertsteigerung (Cap). Für die Vorstandsmitglieder dienen die Aktienoptionen gleichzeitig als variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung.

In den vergangenen beiden Jahren hat der Aufsichtsrat kein neues Aktienoptionsprogramm beschlossen. Vor dem Hintergrund des im Vergleich zur früheren Behandlung nach US-GAAP höheren Aufwands, der sich nach der von IFRS 2 vorgeschriebenen Bilanzierung nach dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) ermittelt, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, dass andere Maßnahmen zur Incentivierung von Mitarbeitern und Vorständen eingesetzt werden sollen.

Qualität, Sicherheit und Umweltschutz

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine Null-Fehler-Strategie um und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitätsniveau. Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Werkzeuge, die Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, ständige Analysen und statistische Verfahren ermöglichen das hohe Qualitätsniveau. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehäusespezifische Merkmale.

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitätsmanagementsystem, das alljährlich gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert wird. Diese Normen wurden in der ISO/TS 16949: 2002, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS Advanced Packaging und GED sowie erstmalig auch SMI und die Fertigung in Duisburg wurden in 2006 gemäß dieser Norm auditiert und zertifiziert.

Arbeitsicherheit und Umweltschutz sind neben der Qualität der Produkte und der Wirtschaftlichkeit als gleichrangige Unternehmensziele festgelegt. Zu den Grundsätzen der Umweltpolitik bei ELMOS zählen Rechtskonformität, Minimierung von Umweltbelastungen, Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter, Umweltschutz-Management, kontinuierliche Verbesserung und Kommunikation.

Das Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund in 2003 durch den TÜV Rheinland zertifiziert und in den nachfolgenden Jahren durch Überwachungsaudits ohne Abweichungen bestätigt. Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Prävention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

Neben der Veröffentlichung des Umweltberichts für 2005, der ausführlich über die umweltrelevanten Tätigkeiten, die davon ausgehenden Umweltauswirkungen sowie über die Organisation der Arbeitssicherheit informiert, hat ELMOS seine hohen sozialen, ökologischen und ökonomischen Ansprüche in einem „Kodex des verantwortungsvollen Handelns“ zusammengefasst. Der Kodex berichtet detailliert über die Verantwortung für das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Umwelt und die Gesellschaft. Dieser Verhaltenskodex richtet sich an alle Führungskräfte und Mitarbeiter des ELMOS-Konzerns. Damit wollen wir – für jedermann nachvollziehbar – zu einwandfreiem Verhalten anhalten und mehr Transparenz schaffen. Dieses wird honoriert durch den Kapitalmarkt, indem ELMOS von Kempen Capital Management und SNS Asset Management als Unternehmen prämiert worden

ist, welches speziellen Wert auf Umweltfreundlichkeit und soziale Belange legt. Parallel zu der Prämierung ist ELMOS als Kandidat für den Kempen/SNS Smaller Europe Social Responsibility Index ausgewählt worden.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9 Prozent größter Einzelaktionär der ELMOS Semiconductor AG. Daher hat der Vorstand gemäß §312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklärung gemäß §312 Abs. 3 AktG abschließt:

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen und die Maßnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von §312 AktG haben sich aus den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für uns nicht ergeben.“

ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG nach HGB

<i>In Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben</i>	2005	2006	Veränderung
Umsatzerlöse	124,9	143,1	14,6 %
Materialaufwand	47,6	58,6	23,3 %
Personalaufwand	30,2	33,6	11,3 %
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9,3	11,0	17,9 %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8,1	3,3	-59,6 %
Jahresüberschuss	6,1	2,4	-60,7 %

UMSATZ- UND ERTRAGSENTWICKLUNG

2006 war durch ein schwieriges Marktumfeld gekennzeichnetes Jahr für ELMOS, das aber insgesamt zufriedenstellend verlief. Zusätzlich mussten die deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten aufgefangen werden. Der Materialaufwand ist um 23,3 Prozent auf 58,6 Millionen Euro gestiegen. Durch die hohen Belastungen aus dem Anlauf der Fertigung in Duisburg und dem ungünstigeren Produktmix blieben, wie erwartet, die Margen unter Druck. Bedingt durch den Anstieg der Aufwandspositionen hat sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 8,1 Millionen Euro um -59,6 Prozent auf 3,3 Millionen Euro rückläufig entwickelt. In ähnlichem Ausmaß hat sich der Jahresüberschuss reduziert.

FINANZLAGE

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemäß HGB

<i>In Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben</i>	2005	2006	Veränderung
Periodenergebnis	6,1	2,4	-60,7 %
Abschreibungen/Zuschreibungen	9,3	11,2	20,4 %
Veränderungen von Rückstellungen und Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen	-2,0	0,5	>100 %
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-7,0	-7,9	-12,7 %
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	8,0	11,8	48,1 %
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	14,4	18,0	25,0 %
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-26,3	-15,0	75,3 %
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	7,3	1,5	-79,5 %
Abnahme / Zunahme der Finanzmittel	-4,7	4,5	>100 %
Finanzmittel am Ende der Periode	7,2	11,8	63,9 %

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich um fast vier Millionen Euro angestiegen. Der deutlich gestiegene Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist unter anderem auf die Entwicklung des Postens Abschreibungen/Zuschreibungen sowie bei der Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva zurückzuführen. Zudem war der Cash Flow aus Investitionstätigkeiten um rund elf Millionen Euro geringer als in 2005. Die Investitionen entfielen vor allem auf das Dortmunder Frontend und Backend für Maschinen und Betriebsvorrichtungen sowie auf die Ausstattung des Reinraums am Standort Duisburg. Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat die in 2006

erforderlichen Investitionen mehr als decken können. Die darüber hinaus zur Verfügung stehende Liquidität wurde hauptsächlich zur Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten genutzt.

VERMÖGENSLAGE

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemäß HGB

<i>In Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben</i>	31.12.2005	31.12.2006	Veränderung
Anlagevermögen	132,5	129,8	-2,0 %
Langfristige Forderungen	1,4	0,1	-92,9 %
Vorräte	21,5	25,4	18,4 %
Kurzfristige Forderungen	41,6	47,6	14,3 %
Flüssige Mittel	7,9	12,9	62,7 %
Übrige Aktiva	1,4	5,9	>100 %
Eigenkapital	146,8	149,2	1,6 %
Langfristige Verbindlichkeiten	2,9	1,9	-32,8 %
Kurzfristige Verbindlichkeiten	55,2	70,3	27,3 %
Bilanzsumme	204,9	221,5	8,1 %

Die Bilanzsumme ist von 204,9 Millionen Euro am 31. Dezember 2005 auf 221,5 Millionen Euro am 31. Dezember 2006 gestiegen. Einflussfaktoren waren u.a. der Anstieg der zur Veräußerung gehaltenen Wirtschaftsgüter. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Erweiterung des Produktionsgebäudes in Dortmund, welches im Jahr 2007 im Zuge einer Sale & Lease-back Transaktion veräußert werden soll.

Berichterstattung nach §289 Abs. 4 HGB bzw. §315 Abs. 4 HGB i.d.F. des Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetzes

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2006 aus 19.413.805 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von 19.413.805,00 Euro ist voll eingezahlt.

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

3. Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich bis zum 31. Dezember 2006 wie folgt dar:

	Euro	%
EFH ELMOS Finanzholding GmbH	1.485.789,00	7,6
Hinrichs GmbH	3.236.584,00	16,7
Dr. Weyer GmbH	3.236.584,00	16,7
ZOE-BTG GmbH	2.306.833,00	11,9
Streubesitz	9.148.015,00	47,1
	19.413.805,00	100,0

4. Inhaber von Aktien mit Sonderrechten

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

5. Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von Arbeitnehmerbeteiligungen

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

6. Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und über Satzungsänderungen

Wir verweisen auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften für die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands (§§84, 85 AktG) sowie für die Änderung der Satzung (§§133, 179 AktG). Ergänzende Bestimmungen aus der Satzung ergeben sich nicht.

7. Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.650.000,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und gem. §204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um 886.195,00 Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogrammes der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu 5.000.000,- Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus

bis zum 25.04.2007 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100%ige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100% igen Beteiligungsgesellschaften bis zum 25.04.2007 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um 930.000,- Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen („Aktienoptionsplan 2004“). Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. April 2004 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese wirksam ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 18.11.2007 eigene Aktien zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien, auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe von bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals entfällt, beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden.

8. Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in

Folge eines Übernahmeangebots stehen

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

9. Entschädigungsvereinbarungen

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

Gesamtbezüge des Vorstands

Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe Bezüge und variable, erfolgsorientierte Bezüge auf, die sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ableiten. Demnach betragen die Bezüge des Vorstands für 2006 insgesamt 2.087 Tausend Euro. Hiervon entfällt auf den fixen Bestandteil 1.522 Tausend Euro und auf den variablen Teil 565 Tausend Euro.

In der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 wurde mit einer 3/4 Mehrheit beschlossen, die Angaben gem. § 285 I Nr. 9a Satz 5-9 HGB für die folgenden fünf Jahre zu unterlassen.

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im Geschäftsjahr 2006 132 Tausend Euro. Für sie wurde eine Pensionsrückstellung in Höhe von 1.035 Tausend Euro gebildet.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Vorstand

Dr. Klaus Weyer	10.000 Stück	25.000 Optionen
Dr. Anton Mindl	7.250 Stück	0 Optionen
Dr. Frank Rottmann	0 Stück	9.200 Optionen
Reinhard Senf	1.948 Stück	40.000 Optionen
Nicolaus Graf von Luckner	1.000 Stück	0 Optionen

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich für 2006 insgesamt auf 100 Tausend Euro. Hierbei handelt es sich nur um fixe Bestandteile (inkl. Spesen und Auslagen).

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2006 keine Aktienoptionen mehr ausgegeben.

Für sonstige Dienstleistungen – insbesondere Beratungen – vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2006 276 Tausend Euro.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer	0 Stück	0 Optionen
Herbert Sporea	4.165 Stück	0 Optionen
Jörns Haberstroh	3.956 Stück	0 Optionen
Dr. Peter Thoma	9.200 Stück	40.000 Optionen
Dr. Burkhard Dreher	1.900 Stück	0 Optionen
Jutta Weber	200 Stück	0 Optionen

Risikobericht

Risikomanagementsystem

Die ELMOS Semiconductor AG hat im Berichtsjahr das in 2002 eingerichtete umfassende Risikomanagementsystem, das die Anforderungen des §91 (2) AktG erfüllt, Schritt für Schritt auf die Unternehmen im Konzern angewendet, weiter verfeinert und anwenderfreundlicher gemacht. Das Risikomanagementsystem von ELMOS und seine Anwendung wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresende kritisch auf Konformität mit den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und Aktiengesetzes geprüft und für geeignet befunden, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen. Es sieht die regelmäßige Erfassung und Bewertung von neuen und bekannten Risiken durch die verantwortlichen Mitarbeiter vor und legt ein geschlossenes Reporting-System fest. Die Unternehmensbereiche der ELMOS-Gruppe berichten auf monatlicher Basis über die finanzielle und operative Entwicklung. Durch diese Maßnahmen werden Vorstand und Aufsichtsrat regelmäßig und frühzeitig über die Risikolage informiert und können geeignete Maßnahmen zur Risikominderung bzw. -vermeidung oder -abwehr beschließen. Das Risikomanagementsystem wird auch zukünftig kontinuierlich erweitert und entsprechend sich ändernder Rahmenbedingungen verbessert werden.

Es ist die Strategie von ELMOS, Zins- und Währungsrisiken durch geeignete Instrumente, wie entsprechende Derivatprodukte, abzusichern. ELMOS geht dabei zeitweise Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kurssicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkurschwankungen auf die Ertragslage. ELMOS beteiligt sich nicht an Spekulationsgeschäften.

Abhängigkeit von der Automobilindustrie

Das Kerngeschäft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach ASICs. Rund 90 Prozent des Umsatzes wird mit Halbleitern für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits abhängig von den produzierten Stückzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Durch die Zunahme an elektronischer Ausrüstung im Auto steigen die Stückzahlen an verkauften ASICs auch dann, wenn die Zahl der produzierten PKWs stagniert oder abnimmt.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlüssen von Systemherstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren, beachtlichen Schwankungen. Die ELMOS-Kundenstruktur lässt sicherlich eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen Automobilzulieferern erkennen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der von einem Kunden generierte Umsatz in der Regel nicht nur durch ein Produkt entsteht, das heißt auch überlappende Lebenszyklen damit verbunden sind. Aufgrund der Bedeutung und der Spezialisierung der ASICs von ELMOS für das Produkt des Automobilzulieferers handelt es sich bei der Beziehung zum Kunden um eine gegenseitige Abhängigkeit. Daher können größere Umsatzvolumina mit einigen Großkunden Zeichen für eine langfristige Kundenbeziehung mit entsprechenden Umsatzpotenzialen sein. Es kommt nur bei sehr großen Volumina vor, dass ein und derselbe ASIC an zwei Lieferanten gleichzeitig vergeben wird, da die Automobilzulieferer selbst unter erheblichem Kostendruck stehen und die gleichzeitige Entwicklung eines ASICs durch zwei Lieferanten erhebliche Mehrkosten zunächst im Entwicklungsbereich und später wegen der geringeren Stückzahlen für den einzelnen ASIC-Lieferanten im Fertigungsbereich bedeuten. Durch die verstärkte Hinwendung von ELMOS zu anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSP) wird diese Kundenabhängigkeit verringert, da solche Produkte an viele Kunden verkauft werden können.

Wettbewerb

Sowohl im Automobil- wie auch im Konsum- und Industriebereich agiert ELMOS stets aus geschützter Position, entweder technologiebedingt oder aufgrund speziellen Anwendungs-Know-hows. Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt für automobiler Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie ELMOS auf vergleichbarer technologischer Grundlage an. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass große Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Dies geschieht insbesondere in Phasen, in denen das klassische Halbleitergeschäft in den Bereichen Speicherchips und Telekommunikation Rückgänge zu verzeichnen hat. Da diese Großproduzenten aus Rentabilitätsgründen sich oftmals auf großvolumige Projekte fokussieren müssen, ist ihr Engagement im Nischenmarkt der kundenspezifischen Schaltungen relativ gering. Damit erscheint das Risiko für ELMOS vergleichsweise gering. Allerdings akquiriert ELMOS in letzter Zeit vermehrt großvolumigere Aufträge. Dadurch wird ELMOS in Zukunft mehr in Wettbewerb zu Großproduzenten treten und entsprechenden Preisdruck spüren. Insbesondere seit 2005 hat ELMOS die negativen Folgen des Wettbewerbs insofern gespürt, als einige Projekte nicht bis in die Produktion gebracht werden konnten, da die Kunden aufgrund von Parallelentwicklungen auf einen Wettbewerber zurückgreifen konnten.

Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how – jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich für ELMOS, wie für jedes Technologieunternehmen, eine erhöhte Abhängigkeit von bestimmten Mitarbeitern.

Entwicklung neuer Produkte und Technologien

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten ist zu berücksichtigen, dass bei der Akquisition eines neuen Auftrages die Einmalkosten im Entwicklungsbereich heute in der Regel nicht mehr in vollem Umfang von den Kunden bezahlt werden. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten werden über die späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert. Hier besteht das Risiko, dass bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung münden,

nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. Gerade bei den hochvolumigen Aufträgen, um die sich eine größere Anzahl von Wettbewerbern bemüht, ist der Kunde in der Regel nicht bereit, die Entwicklungskosten zu übernehmen, sondern erwartet, dass diese vom Lieferanten vorfinanziert werden. Dies gilt insbesondere für von ELMOS selbst initiierte Produktentwicklungen, da hierfür unter Umständen noch kein fester Kundenauftrag vorliegt.

Bei Entwicklungen von Produkten, die ELMOS nicht rechtzeitig fertig stellt, kann die Lieferung möglicherweise erst ein Jahr später oder im schlimmsten Fall gar nicht erfolgen, wenn der Kunde eine Alternativlösung – entweder vom Konkurrenten oder als konventionelle Lösung – einsetzt.

Der Markt für die ELMOS-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der ELMOS-Erfolg ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese Produkte von führenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt werden.

Der zukünftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fähigkeit abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie die Konkurrenten muss ELMOS ihre Technologie ständig verbessern und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln. Sollte ELMOS zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Durch die Fähigkeit von ELMOS, ASICs für alle Arten von elektronischen Geräten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in fast allen elektronischen Komponenten eines PKWs vertreten, so dass das Risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut ist. Zwar könnte ein mehrjähriger Einbruch der Automobilindustrie, der die Automobilunternehmen veranlasst, keine neuen elektronischen Produkte zu entwickeln, die Gesellschaft in ihrer Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen. Ein derartiger Einbruch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abzusehen, insbesondere weil die Automobilindustrie in schlechteren Zeiten eher dazu neigt, die technische Ausstattung zu erhöhen.

Beschaffung

Die von ELMOS für die Fertigung benötigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfügbar und unterliegen keinem Monopol. Allerdings zeigte sich im Berichtsjahr eine Verknappung bei Silizium-Wafern, da durch den Boom der Solarbranche die weltweite Nachfrage deutlich gestiegen ist. Branchentypisch ist eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-Bereich. Hier hat ELMOS mit der Tochtergesellschaft ELMOS AP jedoch ihre Wertschöpfungskette vertikal vertieft.

Produkthaftung

Die von ELMOS produzierten ASICs werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmängel der von ELMOS hergestellten ASICs oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind, können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeinträchtigen. ELMOS ist nicht in der Lage, ihre Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion in der Produktion im Regelfall mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft die nach TS 16949 zertifizierten Qualitätskontrollsysteme sowie weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produktfehler möglicherweise erst nach Installation und Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Störungen der Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen führen. Ein Qualitätsproblem ganzer Chargen könnte zudem zu Regressansprüchen der Kunden im Millionenbereich führen. Dieses Risiko ist angemessen versichert. All dies könnte jedoch negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Beteiligungsbereich

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mögliche finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. Hierfür wird das installierte Überwachungs- und Risikomanagementsystem laufend erweitert und verbessert.

Betriebsunterbrechung

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Geschäftsrisiken ist nach Einschätzung von ELMOS das einzige betriebliche Risiko, das die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen und den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das Risiko der Zerstörung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass seit 2006 eine weitere Fertigungslinie (Zoomm-Linie) am Standort Duisburg betrieben wird. Zu einem späteren Zeitpunkt kann auch am Standort Dortmund in einem separaten Gebäude eine weitere Produktionslinie errichtet werden. Damit verfügt ELMOS über mehrere unabhängige Fertigungslinien, die autark produzieren können.

Die üblichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Rückrufs, sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den Fortbestand des Konzerns gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

Nachtragsbericht

Herbert Sporea hat mit Wirkung zum Ende Dezember 2006 sein Mandat im Aufsichtsrat niedergelegt. Dr. Klaus Weyer, Vorstandsmitglied bis Dezember 2006, wurde im Januar 2007 vom Amtsgericht Dortmund zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die über die Besetzung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds entscheidet. Der Hauptversammlung im Mai 2007 soll vorgeschlagen werden, Dr. Klaus Weyer als Aufsichtsratsmitglied für die restliche Amtszeit von Herbert Sporea, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung im Jahr 2010 zu wählen. Es sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

Prognosebericht

Ausrichtung des Konzerns

ELMOS wird sich zukünftig weiterhin als Nischenanbieter auf kundenspezifische Anwendungen für die Automobilindustrie fokussieren. Um die im Berichtsjahr formulierten Ziele zu erreichen, hat ELMOS an vielen Stellen im Unternehmen teils erhebliche Änderungen in Prozessen, Organisationen und der strategischen Ausrichtung vorgenommen und dem weiteren profitablen Wachstum die Basis bereitet. Dabei sind die ELMOS-Technologie, das ELMOS-Design und die Produktion in der ELMOS-eigenen Fertigung feste Säulen dieser Strategie. Das erfolgreiche automobiler ASIC-Geschäft wird ergänzt durch den Aufbau weiterer Geschäftsfelder. Wir sind überzeugt davon, dass diese Felder mittelfristig entscheidende Wachstums- und Ergebnisbeiträge liefern werden. Insgesamt richten wir den Fokus unserer Arbeit auf weiteres ertragreiches Wachstum. Dieser Prognosebericht basiert auf sorgfältiger Analyse der signifikanten Faktoren.

Folgende Themen werden den Geschäftsverlauf 2007 charakterisieren:

- Die Erweiterung der neuen 8-Zoll-Fertigung in Duisburg wird in 2007 intensiv betrieben, so dass sie zunehmend signifikante Liefermengen beiträgt. Auf der Kundenseite werden wir verstärkte Anstrengungen unternehmen, um unsere auf 200mm-Wafern gefertigten Produkte in laufende Serien schneller liefern zu können.
- Wir haben mit der Gründung der Tochtergesellschaft ELMOS Industries das Fundament für ein Wachstum in den Märkten der Industrie- und Konsumelektronik gelegt. Der Umsatzanteil dieser Märkte von derzeit rund zehn Prozent am Gesamtumsatz soll mittelfristig 20 bis 30 Prozent betragen.
- Wir haben in 2006 sechs applikationsspezifische Standardprodukt-Familien (ASSPs) gestartet. Durch den vermehrten Direktvertrieb solcher Produktreihen und der Unterstützung durch ELMOS Industries können wir die Partnerschaft mit schon vorhandenen Kunden auf weiteren Feldern ausbauen. 2007 werden erste Projekte in Serie gehen.
- Unsere Mikrosystemprojekte wecken durchweg großes Interesse bei den Kunden. Wir werden mit neuen Produkten im Jahr 2007 beweisen, dass unsere Pionierarbeit auf diesem Feld den Kunden große Vorteile bei ihren Applikationen bringt.
- Die erweiterte Kooperation mit Freescale Semiconductor für System-in-Package-Solutions eröffnet neue Perspektiven. Die aus dieser Kooperation entstehenden Multi-Chip-Produkte kombinieren die leistungsfähigen 16-Bit Mikrocontroller-Architekturen (MCU) von Freescale mit den applikationsspezifischen Hochvolt-CMOS Chips von ELMOS. Dies hilft uns bei der Entwicklung und Herstellung intelligenter Lösungen für die Komfort- und Karosserieelektronik im Automobil. Im Jahr 2007 werden erste Produkte vorgestellt.
- Mitte 2006 hat die Verlagerung des Standardgehäuse-Assembly von unserer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zu externen Dienstleistern in Asien begonnen, um so Kostenvorteile zu nutzen. Von dem Assembly-Umsatz bei ELMOS AP wurde im vergangenen Jahr bereits mehr als 40 Prozent durch höherwertige Spezialgehäuse erzielt. Nach Abschluss der Verlagerung der Standardgehäuse im zweiten Quartal 2007 wird sich unsere Tochtergesellschaft komplett auf die Entwicklung und Fertigung von Spezialgehäusen konzentrieren.
- Erste Pilotdesigns in hochintegrierten Logikprozessen mit Foundrypartnern wurden realisiert, um uns so Zugang zu modernsten Technologien zu sichern, ohne eigene, hohe Investitionen in

Fertigungseinrichtungen tätigen zu müssen. Im Jahr 2007 wird dieses Projekt mit hohem Engagement weitergeführt.

Die strategischen Ziele werden durch operative Schwerpunktthemen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit unterstützen, begleitet. Beispielsweise werden die Programme für erfolgsbezogene Entlohnung in den Bereichen Produktion, Entwicklung und Vertrieb für eine weitere Effizienzverbesserung in den Abläufen sorgen. Von der Einführung einer verbesserten Balanced Scorecard in der Fertigung versprechen wir uns ebenso weitere Kosteneinsparungen. Die Verlagerung der Standardgehäuse nach Fernost wird mittelfristig ebenfalls positive Beiträge zur Ergebnissituation liefern.

Marktsituation

Für das Jahr 2007 sind die Erwartungen des Zentralverbandes der Elektronik-Industrie (ZVEI) für den gesamten Halbleitermarkt gedämpft positiv. Eine Voraussetzung für ein nennenswertes Wachstum wäre eine positive Trendwende, die spätestens mit Ende des ersten Quartals einsetzen muss. Für die Automobilindustrie zeigen die Prognosen keine größere Veränderung in der weltweiten Nachfrage. Die neuen EU-Regeln hinsichtlich des CO₂ Ausstoßes lösen aber die Diskussion über die Berechtigung von Oberklassefahrzeugen aus, die als Innovationsträger der Automobilelektronik in der Vergangenheit wesentliche Impulse gegeben haben. Auf der anderen Seite finden Hybridkonzepte zunehmende Beachtung. So wird der Elektronikanteil je Fahrzeug in jedem Fall auch weiterhin kontinuierlich steigen und der Markt für automobiler Halbleiter weiter wachsen. Für die automobilen Halbleiterchips wird ein durchschnittliches Wachstum von etwa sieben bis acht Prozent bis 2015 prognostiziert.

Die Marktbedingungen haben sich schneller als jemals zuvor geändert. So fordern unsere Kunden wesentlich mehr Unterstützung bei der Integration unserer Chips in ihre Applikationen. Das bedeutet einerseits Mehraufwand, andererseits aber eine Chance zur Marktdifferenzierung. Das gilt vor allem dann, wenn wir patentierte Technologien in unseren Produkten, wie z.B. das neue Konzept zur Ansteuerung von Bürstenlosen-Motoren, namens VirtuHall®, einsetzen.

Das Marktumfeld in den USA wird weiterhin schwierig bleiben. Auch bei den Kosten für Rohstoffe und Energie rechnen wir mit keiner Entlastung in 2007.

Erwartete Finanzlage

Wir bestätigen die Prognose aus Dezember 2006. Dementsprechend rechnen wir mit einem Umsatzanstieg von rund zehn Prozent. Die Bruttomarge wird rund 45 Prozent betragen. Beim EBIT gehen wir von rund zwölf Prozent vom Umsatz aus. Die Zielgröße für das Nettoergebnis ist rund sieben Prozent vom Umsatz. Beim Free Cash Flow wird eine freundliche Entwicklung und dementsprechend ein positives Ergebnis erwartet.

Dortmund, im März 2007

Der Vorstand

Dr. Anton Mindl Nicolaus Graf von Luckner Reinhard Senf Dr. Frank Rottmann